

ニュースリリース

2025年11月25日

重点事業分野である半導体材料事業をさらに拡大

静岡工場 先端半導体材料の新棟が竣工

先端・次世代半導体向け新規材料の開発加速や、高品質な製品のさらなる安定供給を実現

富士フイルム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長・CEO:後藤 禎一)は、半導体材料事業の中核会社である富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:小林 茂樹、以下FFEM)の静岡工場内に建設していた開発・評価用の新棟が竣工し、11月より稼働を開始したことをお知らせします。本投資を通じて、開発品の性能評価や製品の品質評価を行う体制を拡充することで、先端・次世代半導体向け新規材料の開発加速や、高品質な製品のさらなる安定供給を実現。急速に拡大するAIデータセンター向け半導体をはじめとした高度情報化社会を支える半導体の需要増に対応し、半導体材料事業の成長をさらに加速させます。



新棟外観写真

近年、AIや5G、IoTの普及により、半導体市場は急速に成長しており、特にAI半導体などの先端半導体の需要が急増しています。富士フイルムの半導体材料事業は、2021年度から2024年度にかけて売上が約1.7倍に拡大し、富士フイルムグループの成長を牽引する中核事業の一つとなっています。こうした成長を支えるため、2021年度から2024年度にかけて1,000億円以上の設備投資を実施し、2025年度から2026年度にかけてさらに1,000億円以上の投資を計画しています。

静岡工場の新棟では、高い清浄度のクリーンルームに先端評価機器を設置し、開発・生産のための品質評価機能を強化します。また、半導体材料に含まれる微粒子を検査する工程にAI画像認識技術を導入しその分析精度を向上させるなど、AIを活用した高度な品質管理体制を構築します。さらに、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する部門を新棟に配置し、製造工程におけるAIなどの

Cookieの利用について

このウェブサイトはクッキーを使用しています。このサイトを使用することにより、プライバシーポリシー に同意したことになります。

静岡工場は、日本市場に対してだけでなく、グローバルな研究開発・生産拠点と連携しながら、顧客の最先端プロセス技術開発を支援しています。

今回の新棟立ち上げにより、EUV(極端紫外線)^{*1}リソグラフィ用レジストやArF^{*2}、NIL^{*3}などの先端レジスト、さらにはPFASフリー^{*4}材料や世界トップシェアの「Wave Control Mosaic[™]」^{*5}の開発を加速し、次世代半導体の進歩に貢献します。

またこれまでの投資により、次世代半導体パッケージのコア材料のポリイミド^{*6}などの開発・量産体制を強化しています。今後も、AI半導体向けの需要増などに対応するため、生産能力の増強と多様な顧客ニーズにこたえる技術開発を進めます。

富士フィルムは、静岡工場新棟への投資を通じて、半導体材料の開発・生産体制を一層強化し、2030年に向けて市場が倍増すると予測されるAI半導体をはじめとした先端・次世代半導体市場の成長を牽引します。これにより、半導体材料事業の売上拡大と富士フィルムグループ全体の成長を加速していきます。

当社は、フォトレジスト^{*7}やフォトリソグラフィ用周辺材料^{*8}、CMPスラリー^{*9}、ポストCMPクリーナー^{*10}、薄膜形成材^{*11}、ポリイミド、高純度プロセスケミカル^{*12}、イメージセンサー用カラーフィルター材料をはじめとした「Wave Control Mosaic[™]」などをグローバルに展開しています。

当社は今後も、最先端からレガシーノードまで半導体製造プロセスのほぼ全域をカバーする豊富な製品ラインアップに加え、日米欧アジアの主要国に製造拠点を有するグローバルな安定供給体制や高い研究開発力を生かしたワンストップソリューションの提供により、顧客の課題解決に取り組み、半導体産業の発展に貢献しています。

*1 極端紫外線を用い、10ナノメートルより微細な世代に必要とされる最先端リソグラフィ技術。

*2 ArF(フッ化アルゴン)エキシマレーザー光(波長193ナノメートル)を用いる露光手法で、現在最も普及している先端リソグラフィ技術。

*3 ナノインプリントリソグラフィ。半導体製造に用いるウエハー上のレジストに、回路パターンが刻み込まれたマスク(型)をハンコのように押し当てて回路パターンを転写・形成する技術。

*4 PFASとは、ペルフルオロアルキル化合物、ポリフルオロアルキル化合物およびこれらの塩類の総称。具体的には、OECD(The Organization for Economic Co-operation and Development)が2021年に公表した“Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl Substances: Recommendations and Practical Guidance”で示す化合物のことを指す。PFASフリーは、この定義されたグループに該当する物質が含まれていないことを意味する。

*5 広範囲な波長の電磁波(光)をコントロールする機能性材料群の総称。デジタルカメラやスマートフォンに用いられるCMOSセンサーなどのイメージセンサーのカラーフィルターを製造するための着色感光材料を含む。Wave Control Mosaicは、富士フィルム株式会社の登録商標または商標です。

*6 高い耐熱性や絶縁性を持つ材料。半導体の保護膜や再配線層の形成に使用される。

*7 半導体製造の工程で、回路パターンの描画を行う際にウエハー上に塗布する材料。

*8 半導体製造のフォトリソグラフィ工程で使用される現像液やクリーナーなど。

*9 硬さの異なる配線や絶縁膜が混在する半導体表面を均一に平坦化する研磨剤。CMPは、Chemical Mechanical Polishing(化学的機械研磨)の略。

*10 CMPスラリーによる研磨後に、金属表面を保護しながら、粒子、微量金属および有機残留物を洗浄するクリーナー。

*11 低誘電率の絶縁膜を形成するための材料。

*12 洗浄・乾燥工程に使われる高純度薬品。半導体製造の洗浄・乾燥工程で異物を除去したり、エッチング工程にて金属や油脂などを取り除くために使用する化学薬品。

新棟の概要

Cookieの利用について

このウェブサイトはクッキーを使用しています。このサイトを使用することにより、プライバシーポリシーに同意したことになります。

延床面積	約6,400㎡
構造	鉄骨造／全免震構造
階数	地上4階
稼働開始時期	2025年11月
投資金額	約130億円(建屋、装置含む)
用途	先端レジストやWave Control Mosaic™の開発・生産のための品質評価機能強化(クリーンルームの設置・検査装置の導入などを含む)

お問い合わせ	報道関係	その他
	富士フィルムホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ TEL 03-6271-2000	富士フィルム株式会社 エレクトロニクスマテリアルズ事業部 E-mail: shm-ff-em_inquiries@fujifilm.com

* 記事の内容は発表時のものです。最新情報と異なる場合(生産・販売の終了、仕様・価格の変更、組織・連絡先変更等)がありますのでご了承ください。

[富士フィルム広報 X\(旧Twitter\)](#)

[一覧へ戻る](#)

Cookieの利用について

このウェブサイトはクッキーを使用しています。このサイトを使用することにより、プライバシーポリシー に同意したことになります。

©富士フイルム株式会社

Cookieの利用について

このウェブサイトはクッキーを使用しています。このサイトを使用することにより、プライバシーポリシー に同意したことになります。